



2021年3月期(第45期)
決算説明資料

証券コード:5217



テイクオイル株式会社

1. 2021年3月期決算
2. 2022年3月期業績予想
3. 半導体市場予測
4. 新型コロナウイルス感染症対策





1. 2021年3月期決算

(1) 経営成績(連結)

(2) 経営成績(単体)

(3) 売上推移(連結)

(4) 自己資本比率(連結)

(5) 設備投資額・減価償却費(連結)

(6) 製品別売上高

(7) 海外売上比率の推移

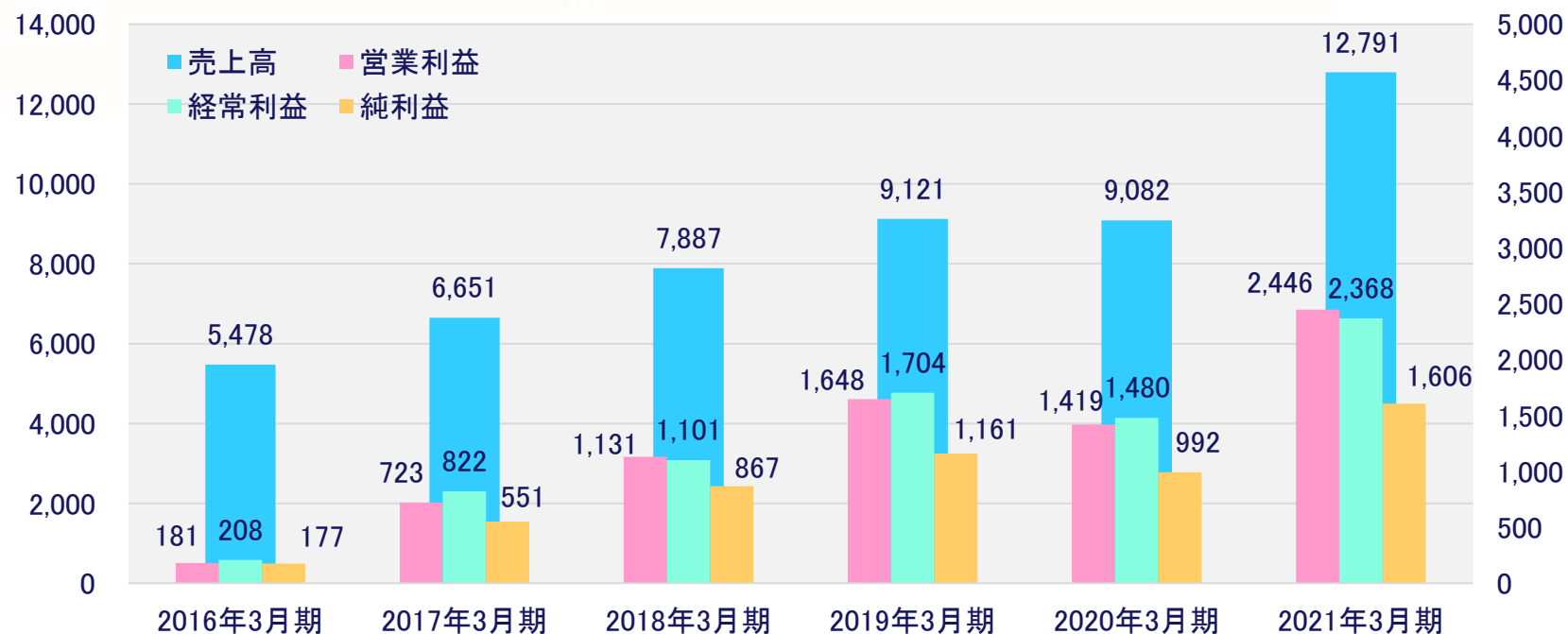
(8) 配当金の推移

1-(1) 経営成績(連結)

(単位:百万円)

	2019年3月期 (第43期)		2020年3月期 (第44期)		2021年3月期 (第45期)	
売上高	9,121	15.7%	9,082	△0.4%	12,791	40.8%
営業利益	1,648	45.7%	1,419	△13.9%	2,446	72.4%
経常利益	1,704	54.7%	1,480	△13.1%	2,368	60.0%
純利益	1,161	33.9%	992	△14.5%	1,606	61.8%

注)%表示 対前年同期比増減率

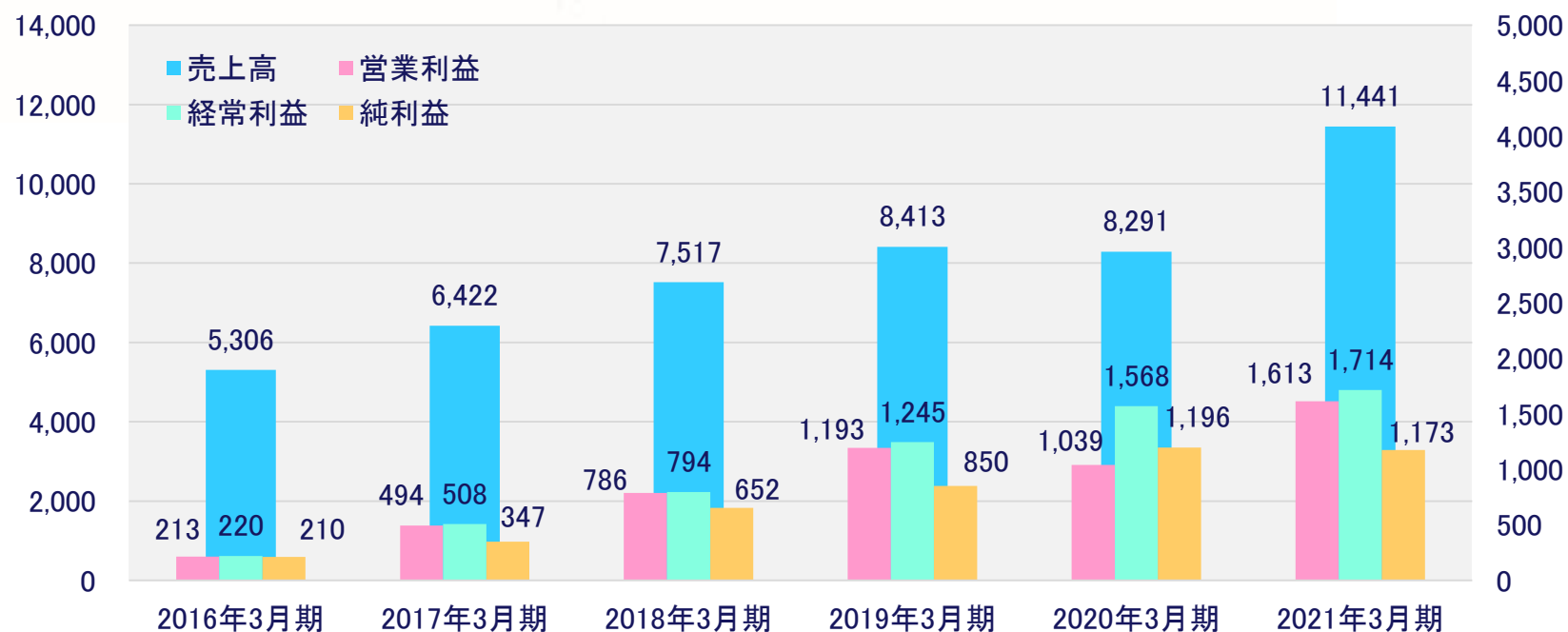


1-(2) 経営成績(単体)

(単位:百万円)

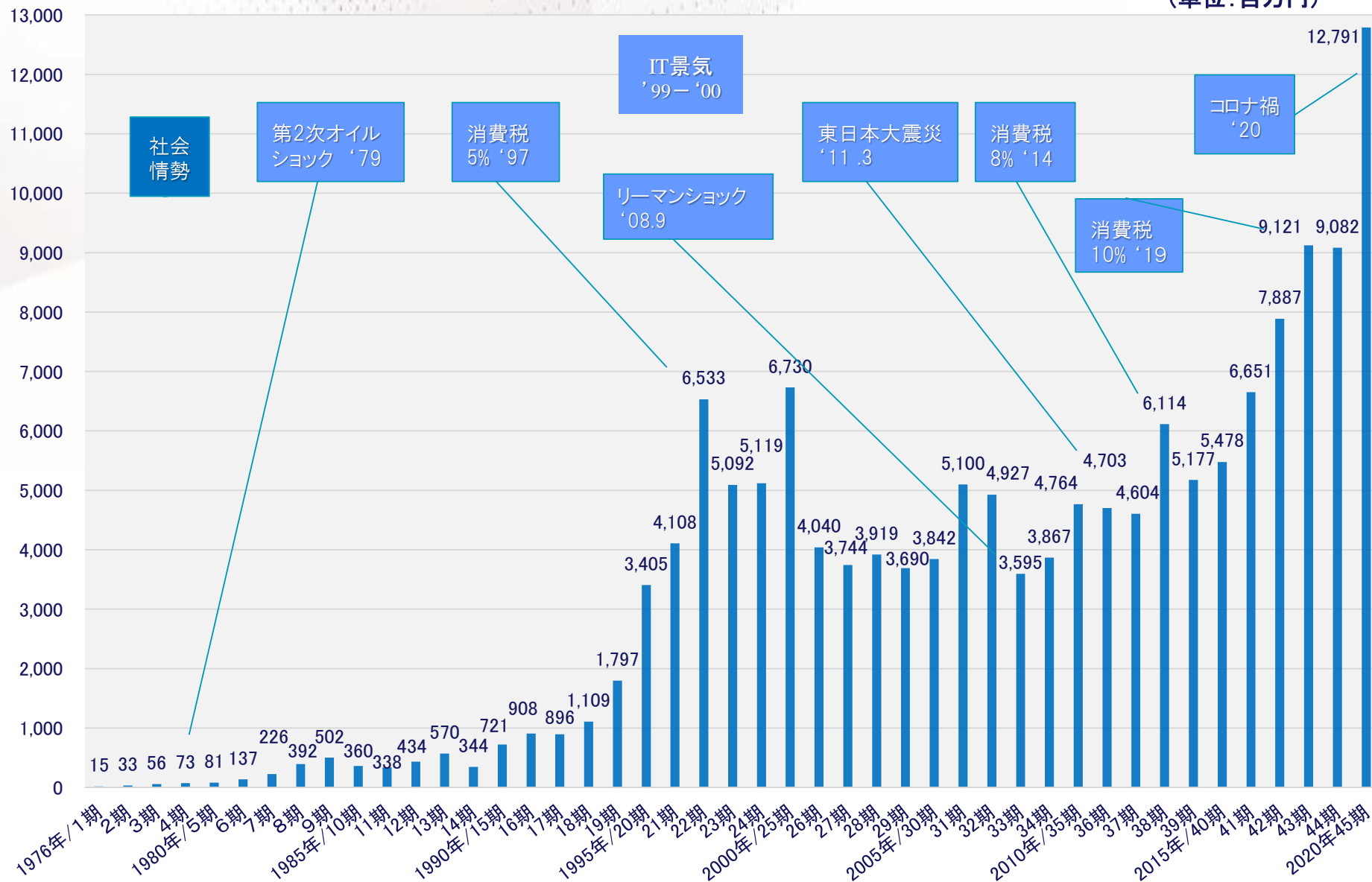
	2019年3月期 (第43期)		2020年3月期 (第44期)		2021年3月期 (第45期)	
売上高	8,413	11.9%	8,291	△1.5%	11,441	38.0%
営業利益	1,193	51.8%	1,039	△12.9%	1,613	55.3%
経常利益	1,245	56.7%	1,568	26.0%	1,714	9.3%
純利益	850	30.4%	1,196	40.6%	1,173	△1.9%

注)%表示 対前年同期比増減率



1-(3) 売上推移(連結)

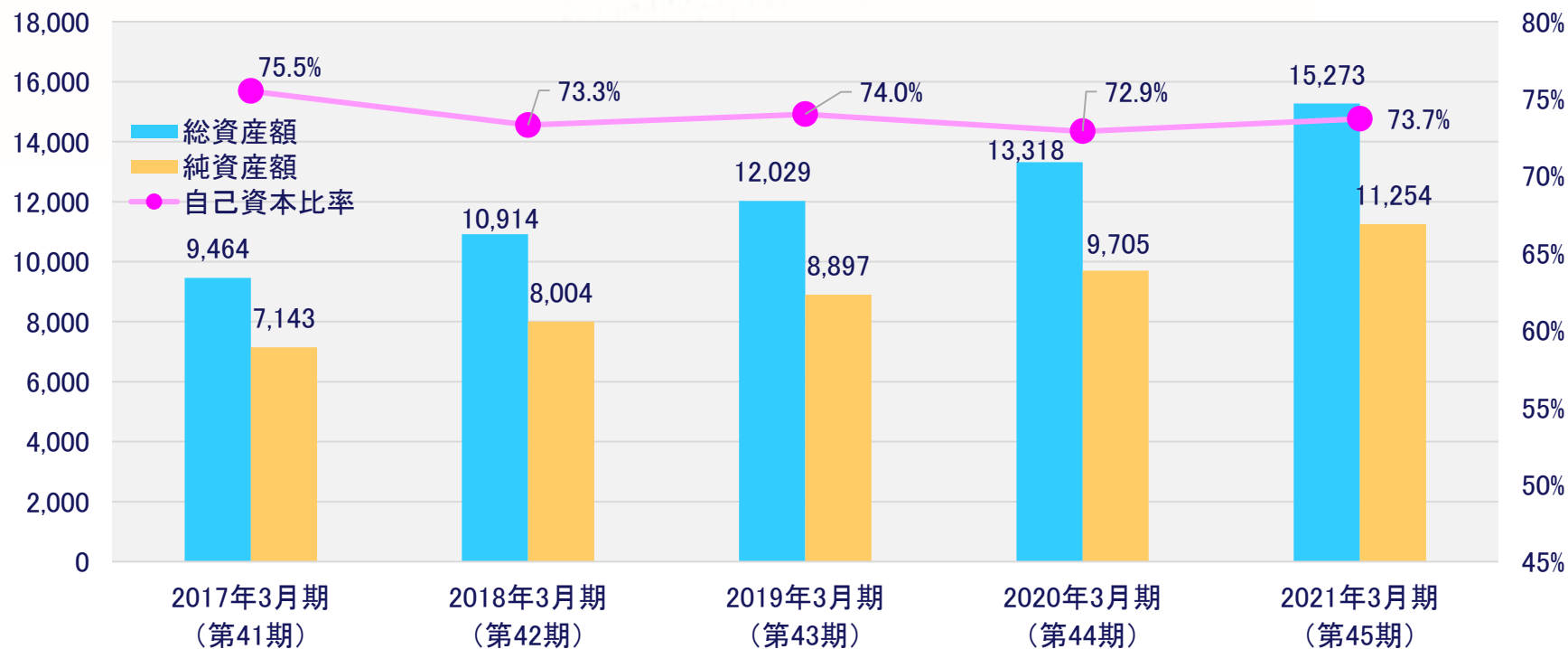
(単位:百万円)



1-(4) 自己資本比率(連結)

(単位:百万円)

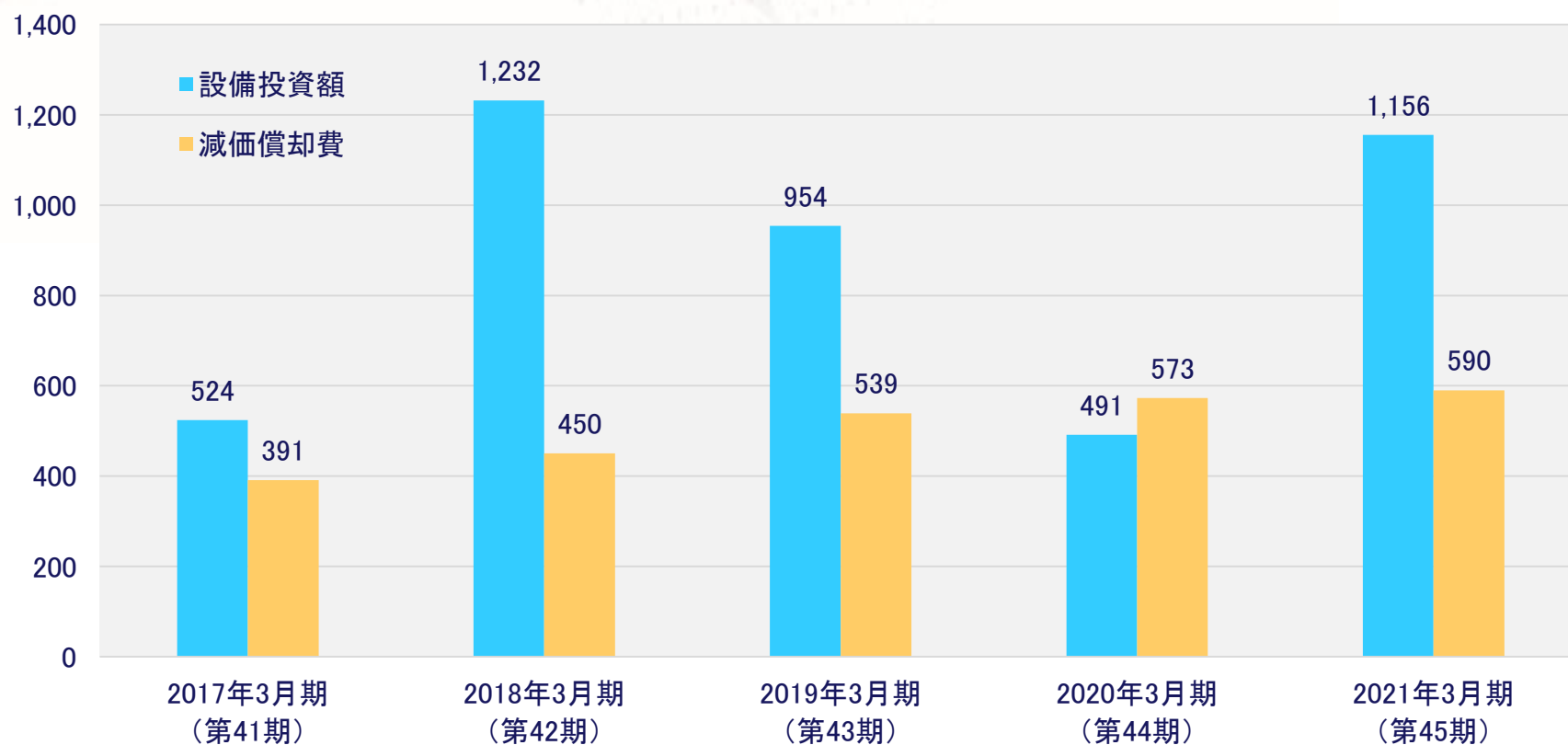
	2017年3月期 (第41期)	2018年3月期 (第42期)	2019年3月期 (第43期)	2020年3月期 (第44期)	2021年3月期 (第45期)
総資産額	9,464	10,914	12,029	13,318	15,273
純資産額	7,143	8,004	8,897	9,705	11,254
自己資本比率	75.5%	73.3%	74.0%	72.9%	73.7%



1-(5)設備投資額・減価償却費(連結)

(単位:百万円)

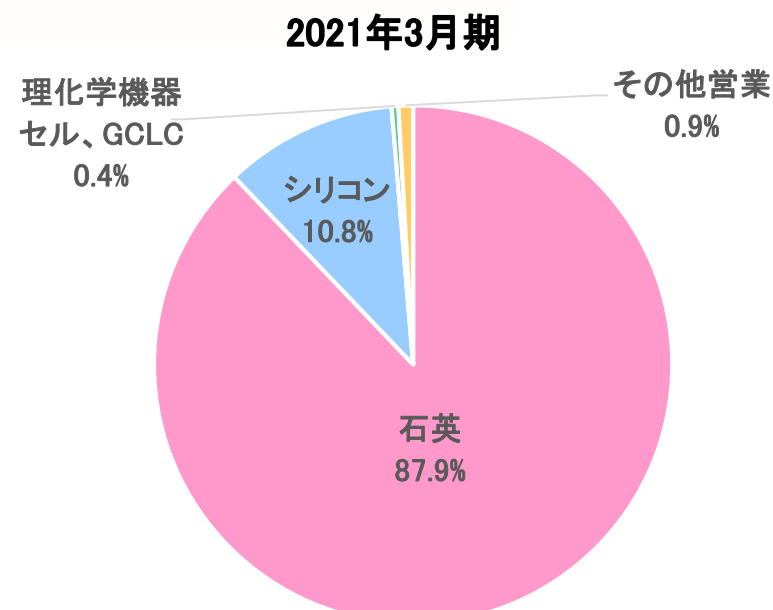
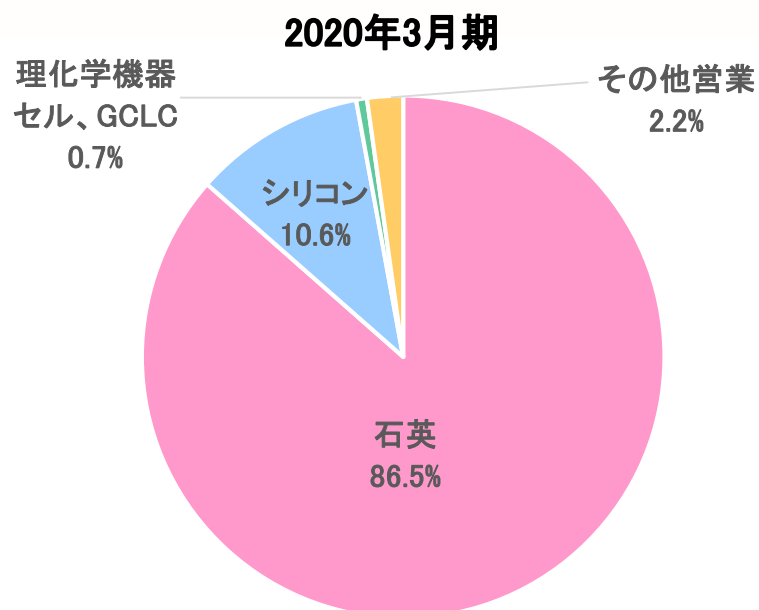
	2017年3月期 (第41期)	2018年3月期 (第42期)	2019年3月期 (第43期)	2020年3月期 (第44期)	2021年3月期 (第45期)
設備投資額	524	1,232	954	491	1,156
減価償却費	391	450	539	573	590



1-(6)製品別売上高

(単位:千円)

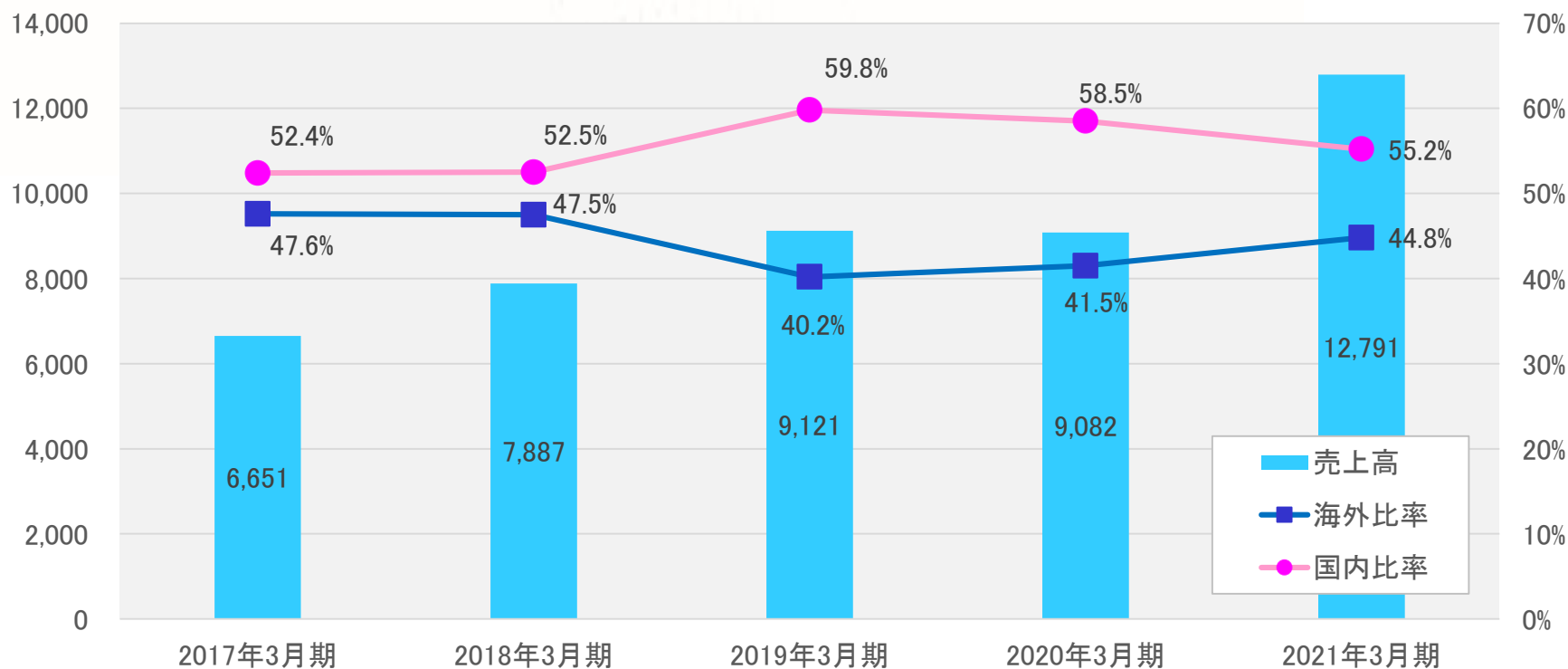
主要製品	2020年3月期			2021年3月期		
	売上高	構成比	前年比	売上高	構成比	前年比
石英	7,855,468	86.5%	99.0%	11,240,046	87.9%	143.1%
シリコン	964,908	10.6%	99.2%	1,380,701	10.8%	143.1%
理化学機器 セル、GCLC	60,718	0.7%	106.4%	53,793	0.4%	88.6%
その他営業	201,659	2.2%	120.6%	116,542	0.9%	57.8%
総計	9,082,754	100.0%	99.6%	12,791,083	100.0%	140.8%



1-(7)海外売上比率の推移

(単位:百万円)

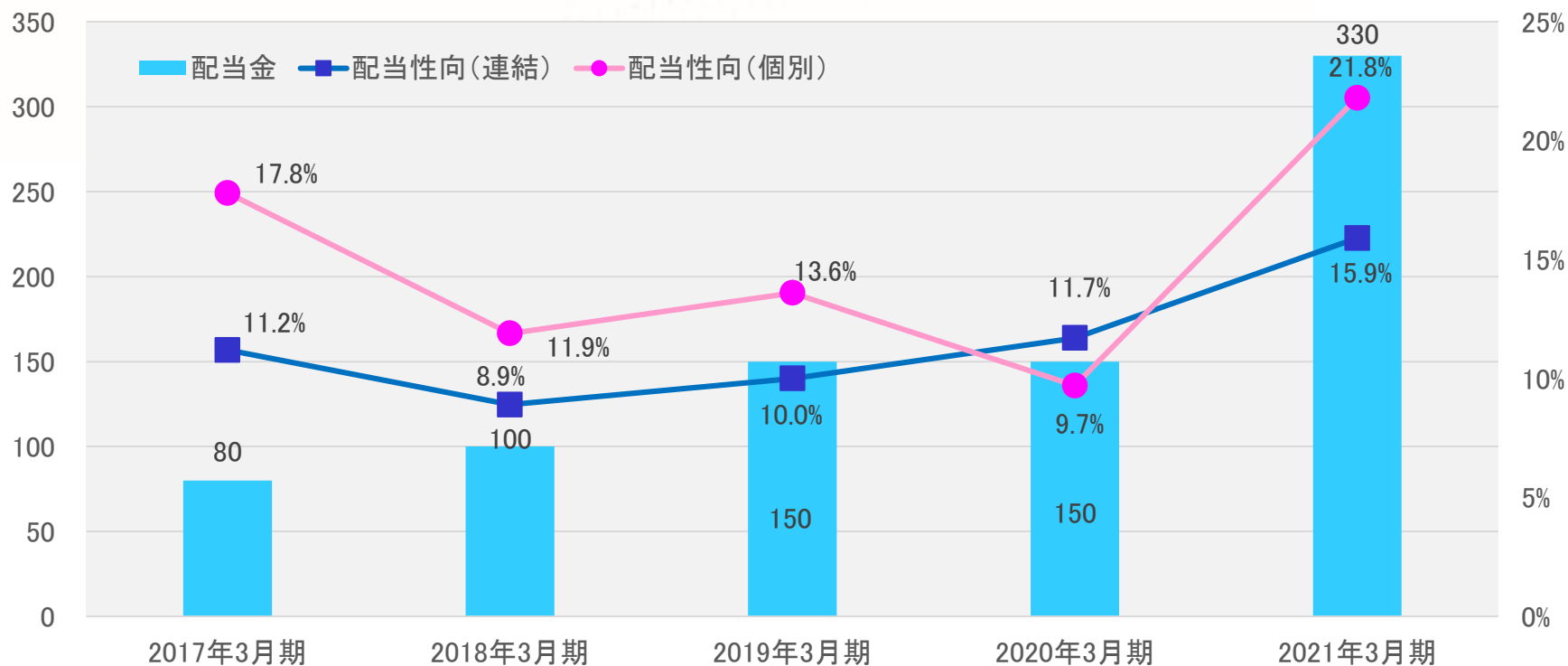
区分	2018年3月期		2019年3月期		2020年3月期		2021年3月期	
	合計	比率	合計	比率	合計	比率	合計	比率
国内	4,142	52.5%	5,453	59.8%	5,317	58.5%	7,059	55.2%
国外	3,745	47.5%	3,668	40.2%	3,765	41.5%	5,731	44.8%
合計	7,887	100.0%	9,121	100.0%	9,082	100.0%	12,791	100.0%



1-(8) 配当金の推移

(単位:円)

	2017年3月期 (第41期)	2018年3月期 (第42期)	2019年3月期 (第43期)	2020年3月期 (第44期)	2021年3月期 (第45期)
1株当たり配当金	80.00	100.00	150.00	150.00	330.00
配当性向(連結)	11.2%	8.9%	10.0%	11.7%	15.9%
配当性向(個別)	17.8%	11.9%	13.6%	9.7%	21.8%



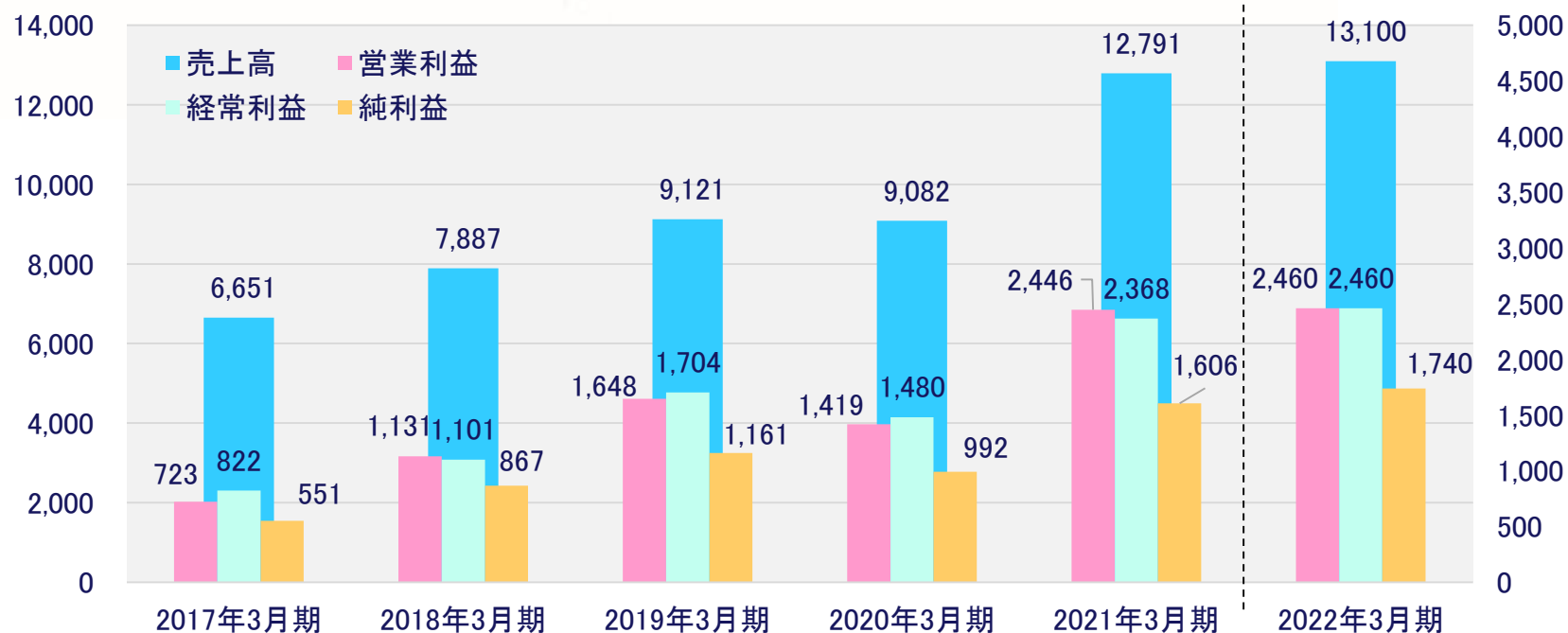
2. 2022年3月期業績予想

(単位:百万円)

	第2四半期		通期	
売上高	6,530	5.4%	13,100	2.4%
営業利益	1,260	△1.2%	2,460	0.6%
経常利益	1,260	△1.4%	2,460	3.9%
純利益	890	1.5%	1,740	8.3%

※2021年3月期決算短信の公表値

注)%表示 対前年同期比増減率



3. 半導体市場予測

(1) 半導体メーカー、半導体装置メーカー売上ランキング

(2) 世界の地域別半導体市場規模

(3) 日本製装置販売高予測

(4) 世界地域別半導体市場予測

出所: WSTS2020秋季半導体市場予測

SEAJ2021年1月日本製装置販売高予測

IC Insights

VLSI Research



3-(1) 半導体メーカー、半導体装置メーカー売上ランキング

2020年半導体メーカー売上ランキング

2020	2019	企業名	国名	売上高 (百万ドル)
1	1	インテル		73,894
2	2	サムスン エレクトロニクス		60,482
3	3	TSMC		45,420
4	4	SK Hynix		26,470
5	5	マイクロンテクノロジー		21,659
6	7	クアルコム		19,374
7	6	ブロードコム		17,066
8	10	Nvidia		15,884
9	8	TI		13,088
10	9	Infineon		11,069

資料: IC Insights

2020年半導体装置メーカー売上ランキング

2020	2019	企業名	国名	売上高 (百万ドル)
1	1	アプライド マテリアルズ		16,365
2	2	ASML		15,396
3	4	ラムリサーチ		11,929
4	3	東京エレクトロン		11,321
5	5	KLAテンコール		5,443
6	6	アドバンテスト		2,531
7	7	スクリーン		2,331
8	8	Teradyne		2,259
9	9	日立ハイテクノロジーズ		1,717
10	10	ASMI		1,516

資料: VLSI Research

3-(2)世界の地域別半導体市場規模

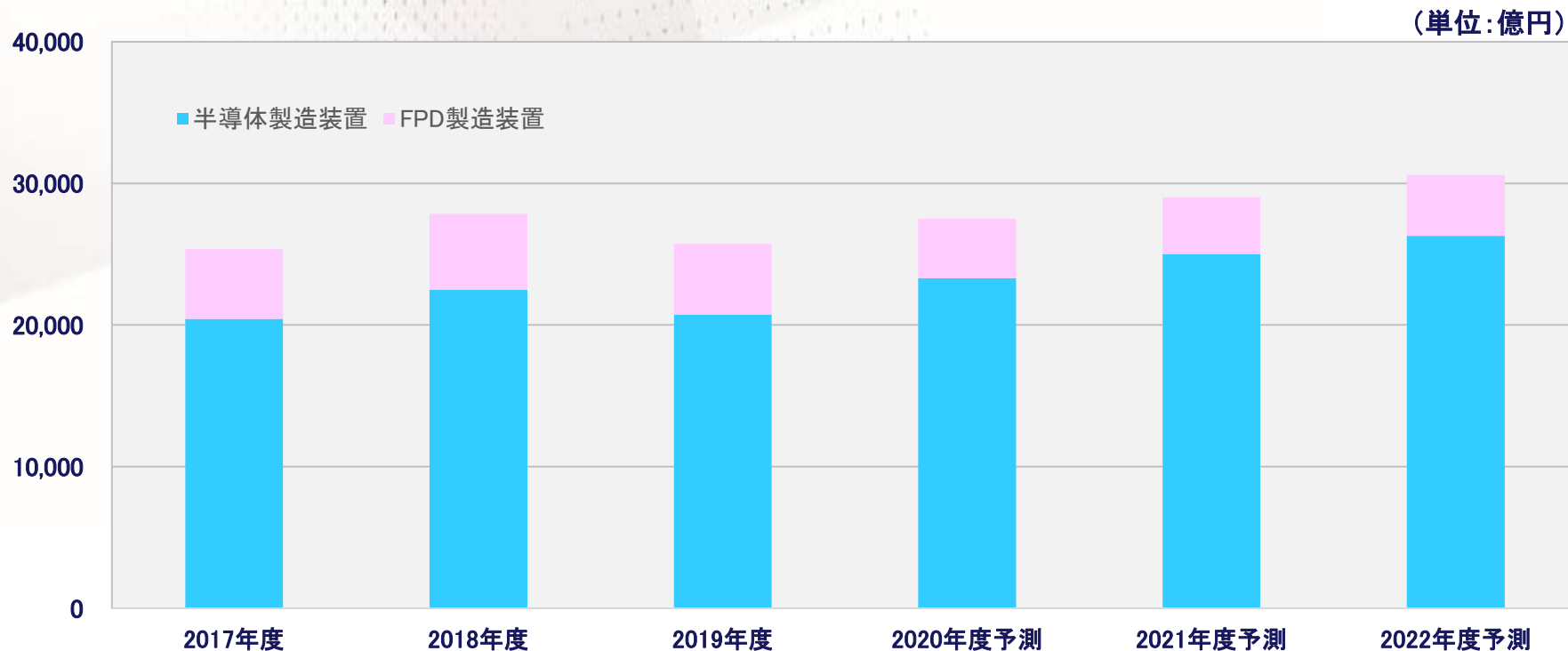
(単位:億米ドル)

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年 予測	2021年 予測
米州	614	693	687	655	884	1,029	786	933	1,021
欧州	348	374	342	327	383	429	398	364	385
A/P	1,744	1,942	2,010	2,083	2,488	2,828	2,578	2,675	2,908
日本	347	348	311	322	365	399	359	357	378
合計	3,055	3,358	3,351	3,389	4,122	4,687	4,123	4,331	4,694
前年比	104.8%	109.9%	99.8%	101.1%	121.6%	113.7%	87.9%	105.0%	108.3%

資料:WSTS 2020年秋季半導体市場予測

※上記WSTS予測は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮していないため、今後の予測値は変動する可能性があります。

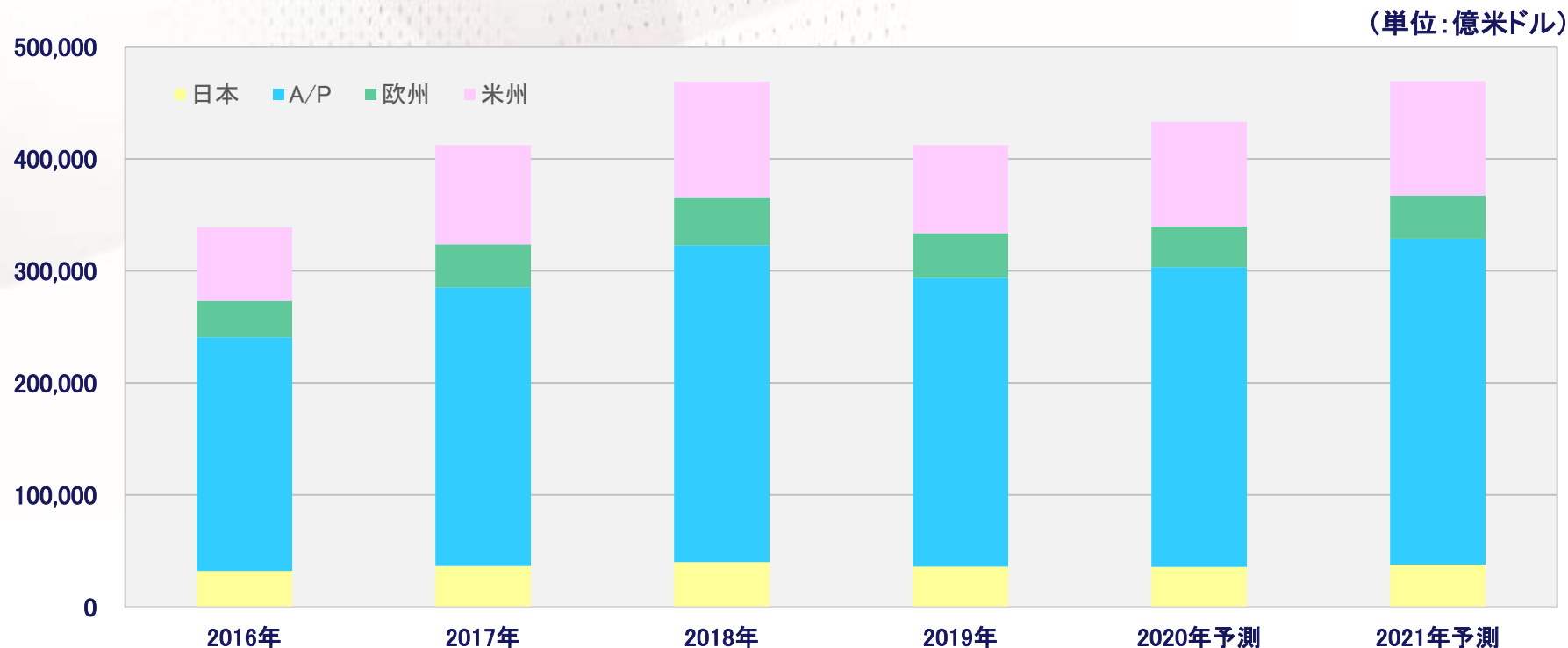
3-(3) 日本製装置販売高予測



日本製製造装置販売高について

- ◆ 2020年度は、半導体製造装置が年度前半のロジック・ファウンドリーの堅調な投資に年度後半からメモリーの復調が加わり前年度比12.4%増、FPD製造装置が海外渡航制限等の影響で同11.7%減、全体で同7.9%増の2兆7,500億円となる見通し
- ◆ 2021年度は、FPDは同4.8%減と若干減りますが、半導体は同7.3%増と引き続き成長を維持するため、全体では同5.5%増の2兆9,000億円と予測
- ◆ 2022年度は、全体で同5.5%増の3兆600億円と予測

3-(4) 世界地域別半導体市場予測



世界半導体市場について

- ◆ 2019年は米中貿易摩擦等の地政学的リスクが世界経済の失速を招き、前年比12.0%減と悪化
- ◆ 2020年は新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延によるマイナス影響がある反面、5Gスマートフォンの需要増加やテレワーク/オンライン授業の拡がり等ライフスタイルの変化が半導体需要を押し上げ、同5.1%増と予測
- ◆ 2021年は新型コロナウイルス感染症を巡る状況の改善を前提に半導体市場も成長が加速すると思われ、同8.4%増と予測

資料: WSTS

4. 新型コロナウイルス感染症対策

＜弊社の対応＞

日々変化する状況に応じて、お客様、従業員およびその家族の安全確保・感染予防、感染拡大防止を最優先とする方針のもと、事業継続に向けた対応を随時実施しております。

現在、お客様に対しましては、各種オンラインシステムを活用した商談や営業活動を行っております。新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めつつ、お客様からのご注文への対応、商品出荷対応等は、通常通り実施しております。

また、社内におきましては、従業員に対し、在宅勤務および時差出勤の導入、出張の制限等を行っているほか、事業部門ごとに事業の継続に向けたコンティンジェンシープランを策定しております。

＜事業面の影響＞

当初は、海外との間で原料調達や製品出荷に一部影響が出ていたところもありましたが、現時点では、新型コロナウイルス感染症拡大による業績への影響は軽微です。なお、今後、業績に重大な影響を及ぼす事象が発生した場合には、適時に開示いたします。

 **テクノクォーツ株式会社**

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2
ハーモニータワー

TEL: 03-5354-8171

FAX: 03-5354-8191

<http://www.techno-q.com/>

【免責事項】

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があることをご了承ください。



中期経営計画

2021年度～2023年度
(2021.4.1～2024.3.31)

【目次】

1. 経営環境
2. 経営理念等
3. 当社のあゆみ
4. 前中計期間中の成果と課題
5. 中期経営計画の概要
6. 参考資料

1. 経営環境

(1) 国内経済の状況

国内経済は、2019年末頃までは、米国の保護主義への傾斜とそれに端を発した貿易摩擦の激化、英国のEU離脱、金融資本市場の混乱、消費税増税等による先行き不透明感から、企業業績の下振れが懸念される局面もありましたが、雇用環境は引き続き良好であり、人手不足を背景に合理化・省力化投資等を中心とした旺盛な設備投資需要にも支えられ、企業業績は堅調に推移していました。

しかしながら、2020年に入り、2月頃から顕在化した新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延で状況は一変、多くの企業で業績が悪化し経済活動も停滞を余儀なくされました。緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置等、様々な活動制約を経ても感染者数の拡大ペースは衰えを見せず、2021年4月時点では東京都や大阪府等に3回目の緊急事態宣言が発出される事態となっており、医療体制の逼迫も危惧されています。

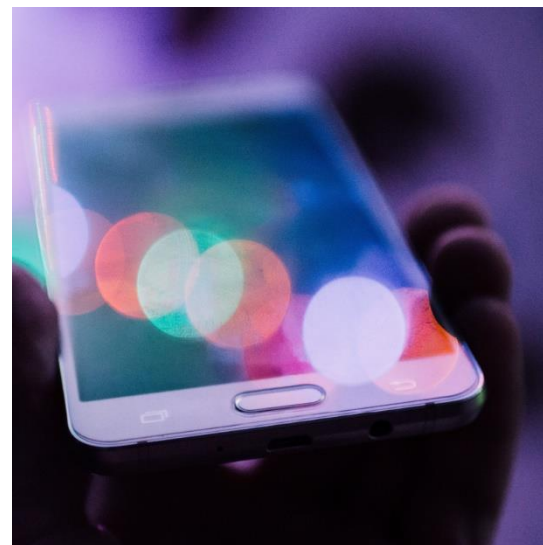
人・モノの動きや経済活動が強く制限されるなか、インバウンド消費の消滅や外出の自粛により、特に宿泊・飲食・旅行・航空等、対個人サービス関連企業を中心に業況は悪化しており、今後の感染拡大ペースやワクチンの接種完了時期等も不透明であることから、先行きが見通せず、多くの企業が対応に苦慮している状況です。



1. 経営環境

(2) 半導体業界の状況

一方、当社グループが属する半導体業界におきましては、2018年秋以降、米中貿易摩擦等の影響から、メモリー投資の減速、データセンター関連需要の低迷等、先行きの需給動向を慎重に見極める状況が続いていましたが、2019年秋頃から、半導体メーカーおよび半導体製造装置メーカー各社の将来見通しは上昇基調に転じました。



2020年に入り、新型コロナウイルス感染症の拡大が世界各地で広がる中、スマートフォンに代表されるコンシューマ製品や車載、産業機器等で、一時消費減少が見込まれる局面もありましたが、テレワークや巣ごもり需要の増大でデータ量が増加し、データセンターなどのインフラ需要は急激に拡大しています。

今回の「コロナショック」を契機に、世界中の人々の行動様式は変化を迫られ、働き方、製造現場、購買行動、教育・医療には大きな変革が求められています。このような新しい行動様式の下では、5GやAI、IoT、自動運転等の需要が益々高まると見込まれ、中長期的には半導体需要は着実に拡大していくと思われれます。

1. 経営環境

(3) 当社の現況と今後の見通し

このような環境の中、当社では、これまでに蓄えた豊富な受注残高と、工場の高稼働に伴う量産効果を背景に、**2021年3月期は、売上高・営業利益・経常利益・当期純利益のいずれも、上場以来最高額を更新することができました。**

また、受注残高につきましては、2019年秋頃から拡大傾向に転じた後、コロナ禍においても拡大を続け、**足元では過去最高レベルの水準で推移している状況**です。



こうした中、当社工場では、国内・海外ともに2交代制を併用しながらのフル操業が続いています。現状の高水準の受注に加え、将来に向けたお取引先からの増産要請も多数抱えていること、そもそものベースとしてデータセンター、5G、AI、IoT、自動運転等による半導体需要の急拡大が見込まれることから、**設備増強や効率化による工場のキャパシティアップが、当社における喫緊の課題**であると言えます。

2. 経営理念等

(1) 経営理念

企業の維持、発展をならしめ、
社員個々の幸福を勝ち取り、
社会に対し社会性を十分発揮して、
その存在価値を高めること

(※「創立の根本精神及び経営理念」より)

(2) スローガン

道は一つ、共に進もう

(※「創立の根本精神及び経営理念」より)

(3) 企業行動指針

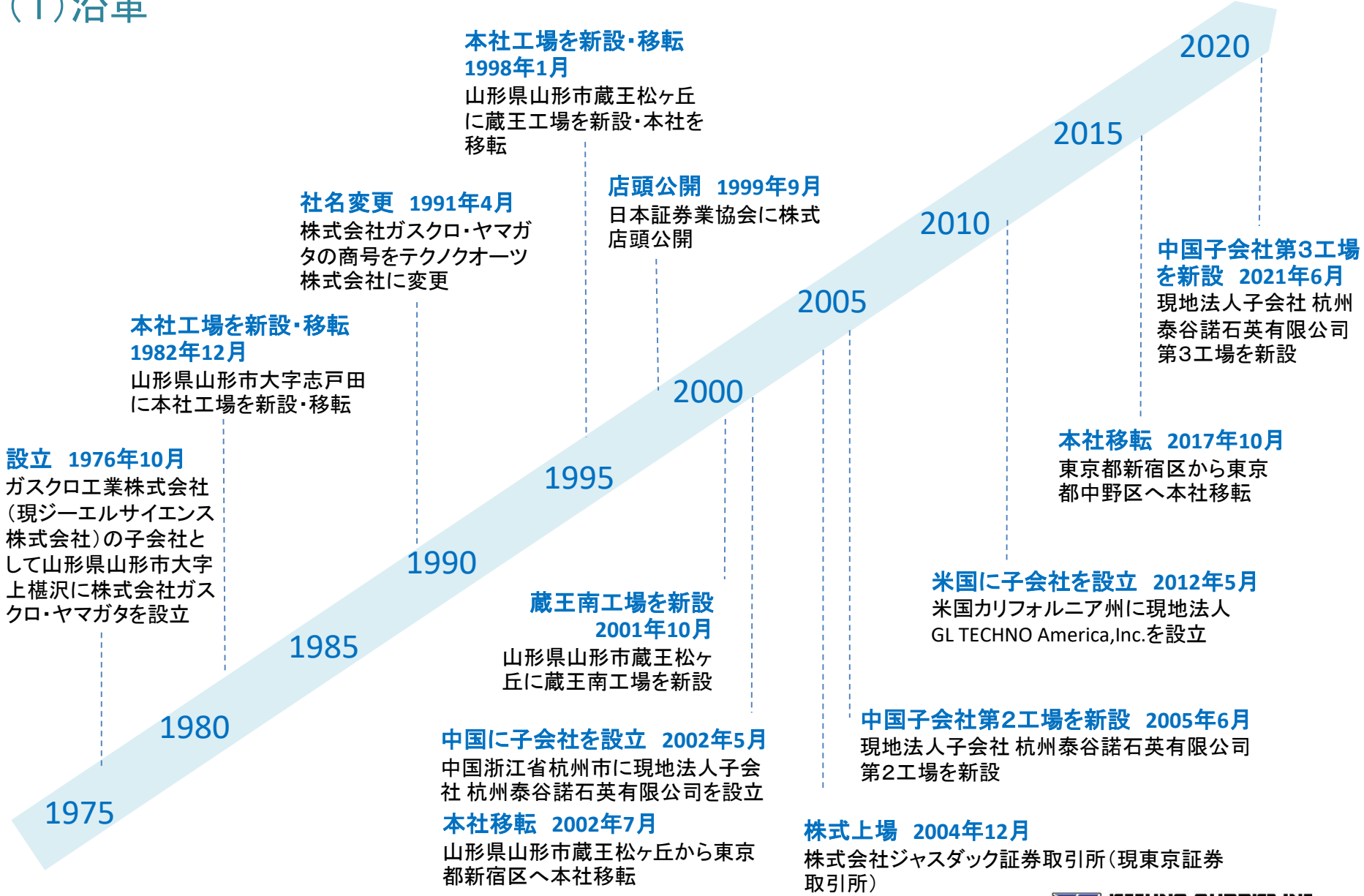
①お客様からの信頼の獲得、②基本的人権の尊重、③倫理的行動の実践
による法令および企業倫理の遵守、④公正・誠実な取引の実施、
⑤反社会的勢力との決別、⑥環境問題への取り組み、⑦企業情報の開示

(※「ジーエルサイエンスグループ企業行動指針」より)



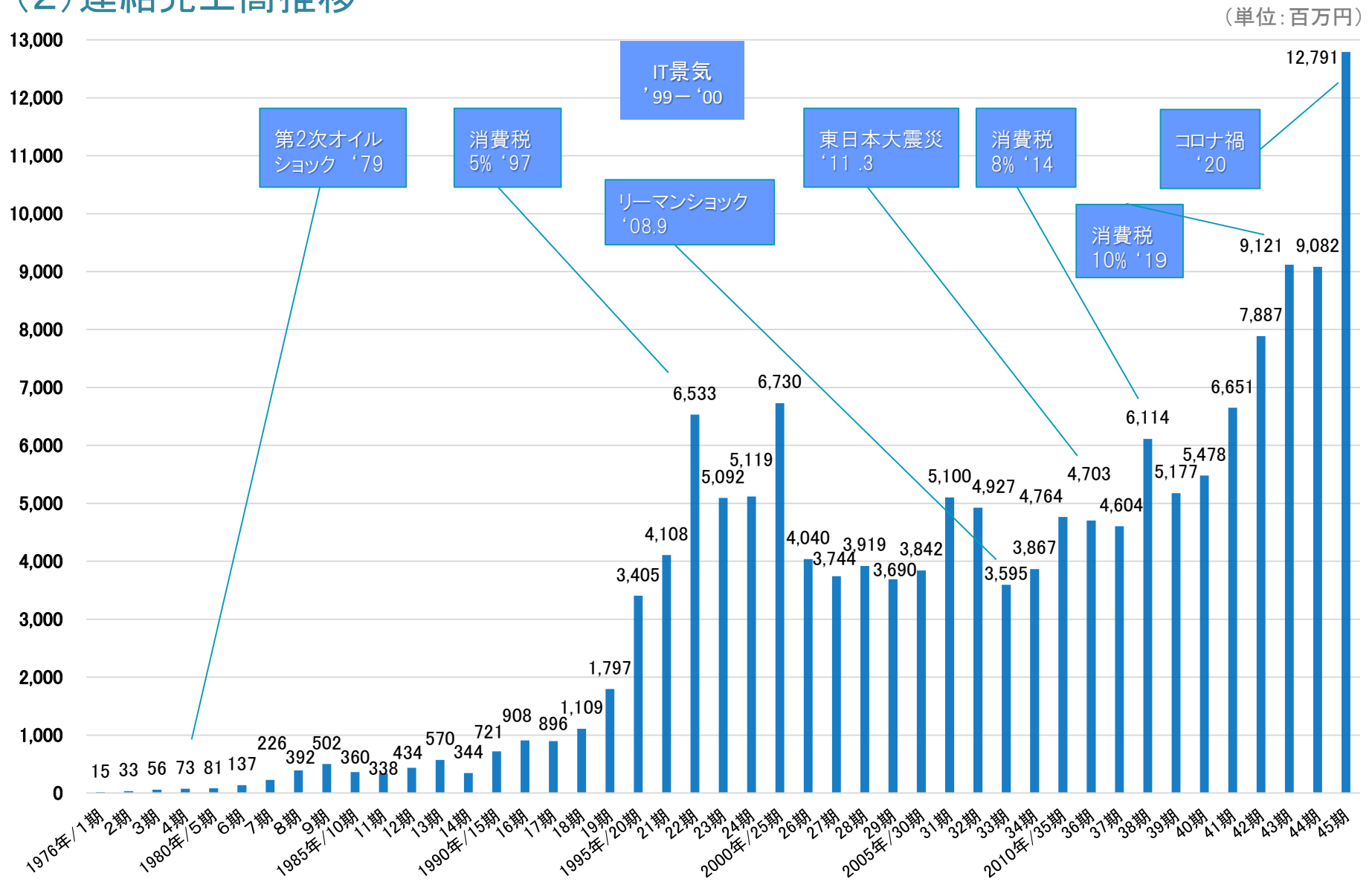
3. 当社のあゆみ

(1) 沿革



3. 当社のあゆみ

(2) 連結売上高推移



4. 前中計期間中の成果と課題

(1) 前中計期間中の成果

- ① 過去最高の売上高および営業利益の達成
- ② 内部管理体制および各種ツールの進捗

(2) 次期中計に向けた課題

- ① 生産能力増強、中国第3工場の建設と量産開始
- ② コロナ禍での営業展開、営業力強化
- ③ 業務効率化、経営基盤強化、人材育成等の推進



5. 中期経営計画の概要

(1) 中期経営計画のビジョン

石英ガラス・シリコン加工における世界有数の
「半導体関連精密パーツ総合メーカー」としての地位確立

(2) 中期経営計画の主な戦略

① 生産能力増強

- ・中国第3工場の稼働(2021年6月末竣工予定)や各工場の生産性向上等により、生産能力の増強を図ります。
- ・品質管理の高度化を進めるとともに、社外パートナー、外注先等との連携強化を通じて、生産能力の向上を目指します。

② 営業力強化

- ・コロナ後のお取引先との関係強化を図るとともに、高付加価値製品の開発と拡張を行い、石英・シリコンの量産品のマーケット拡大を目指します。
- ・シリコン製品の開発品、量産品の更なる売り込み強化するとともに、火加工製品等、高難易度製品の拡大を図ります。



5. 中期経営計画の概要

③業務効率化

- ・業務フロー、作業手順等の見直しを進め、業務自動化・効率化等のDXを推進します。
- ・テレワーク、会議システム等、効率化に資するシステムツールの更なる活用を図ります。

④経営基盤強化

- ・ESG経営、SDGsへの対応を進めるとともに、会社法改正への対応や新市場区分への移行を見据えたコーポレートガバナンスコード等への対応を行います。
- ・財務指標や株価を意識した経営を行い、IR機能強化、リスクマネジメント強化を図ります。

⑤人材育成

- ・各種研修の充実、業務マニュアルの作成推進、人事ローテーションの活発化等により、優秀な人材の育成に努めます。



5. 中期経営計画の概要

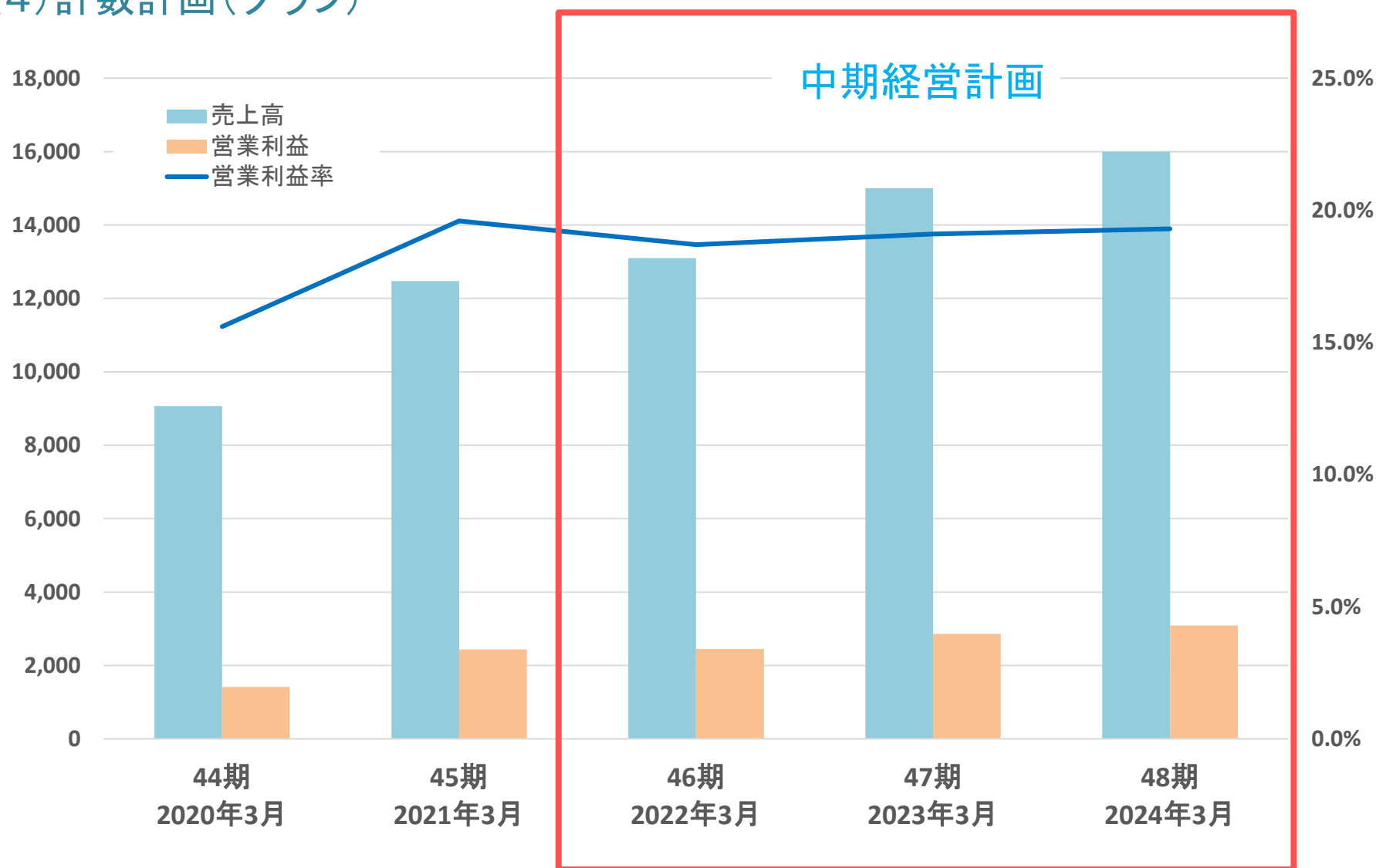
(3) 計数計画

	中期経営計画				
	44期 2020年3月	45期 2021年3月	46期 2022年3月	47期 2023年3月	48期 2024年3月
売上高	9,072	12,791	13,100	15,000	16,000
営業利益	1,416	2,446	2,460	2,860	3,090
営業利益率	15.6%	19.1%	18.8%	19.1%	19.3%

5. 中期経営計画の概要

(単位:百万円)

(4) 計数計画(グラフ)



6. 参考資料

(1) グループ会社の連携

ジーエルサイエンスグループ

分析機器事業

ジーエルサイエンス
株式会社



GL Sciences B.V.

GL Sciences, Inc.

技尔(上海)商貿有限公司

株式会社グロース

株式会社フロム



半導体事業

テクノオーツ
株式会社



杭州泰谷諾石英有限公司



HangZhou
Techno
Quartz

GL TECHNO AMERICA, Inc.



自動認識事業

ジーエルソリューションズ
株式会社



6. 参考資料

(2) ESG経営への取り組み

中期経営計画の主な戦略「④経営基盤強化」の中でも触れておりますとおり、当社では、ESG「(環境: Environment)、(社会: Social)、(企業統治: Governance)」を経営に取り入れ、企業価値の向上を目指しています。

- ・「**環境**」につきましては、政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けて、低炭素・循環型社会への転換に貢献すべく、国内・海外(中国)の当社工場において、極力環境に配慮した製造工法を模索するとともに、廃棄物の削減や分別に鋭意取り組んでおります。
- ・「**社会**」につきましては、半導体事業を通じて世界中の人々に便利で豊かな暮らしを提供することで社会貢献するとともに、企業活動を通じて適正な配当・納税を行うことで、広く株主・社会に利益を還元し、上場企業としての社会的責任を果たして参ります。
- ・「**企業統治**」につきましては、取締役8名中3名を独立且つ社外取締役とすることで経営の客観性を担保するとともに、2022年4月の東証市場再編(当社はジャスダック市場からスタンダード市場に移行予定)を前提に、コーポレートガバナンスコード全78項目の適用を視野に入れたガバナンス体制の構築に向けて取り組んでおります。



6. 参考資料

(3) SDGsへの対応

当社では、ESGと密接に関係するSDGsに対しましても、一体として取り組んでまいります。

現時点では、下記のとおり、主として3、12、17についての取り組みが先行していますが、今後、当社としての正式な目標項目を設定して行く予定です。



番号	項目	ゴール	ターゲット	当社の目標
 3 すべての人に健康と福祉を	全ての人に健康と福祉を	3.9	2030年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。	<ul style="list-style-type: none"> 国内外の生産拠点における有害化学物質の大気・河川・土壌等への排出防止徹底
 12 つくる責任 つかう責任	つくる責任 つかう責任	12.5	2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。	<ul style="list-style-type: none"> 国内外の生産拠点における廃棄物の削減及び分別の徹底 環境に配慮した製造工法の研究推進
 17 パートナリシップで目標を達成しよう	パートナーシップで目標を達成しよう	17.17	様々なパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。	<ul style="list-style-type: none"> 当社国内工場が所在する山形市、聾学校、養護学校等への寄付等を通じた協力 企業、大学、研究機関との共同研究推進

6. 参考資料

(4) 中国第3工場(2021年6月末竣工予定)

- ・現在の中国第1工場・第2工場の隣接地に、総額約27億円で第3工場を建設中です。
- ・最大60台の機械設備設置が可能であり、最大約25億円/年の増産規模となります。

